

证券代码：300456

证券简称：赛微电子

公告编号：2023-033

北京赛微电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	赛微电子	股票代码	300456
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张阿斌	刘波	
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室、北京市北京经济技术开发区科创八街 21 号院 1 号楼	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室、北京市北京经济技术开发区科创八街 21 号院 1 号楼	
传真	010-59702066	010-59702066	
电话	010-82252103	010-82251527	
电子信箱	ir@smeic.com	ir@smeic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、主要业务

公司是全球领先、国际化运营的高端集成电路晶圆代工生产商，也是国内拥有自主知识产权和掌握核心半导体制造技术的特色工艺专业晶圆制造商。公司在国内外拥有多座中试平台及量产工厂，业务遍及全球，服务客户包括国际知名的 DNA/RNA 测序仪、光刻机、计算机网络及系统、硅光子、红外、可穿戴设备、新型医疗设备、汽车电子等巨头厂商以及细分行业的领先企业，涉及产品范围覆盖了通讯、生物医药、工业汽车、消费电子等诸多领域。公司同时正在打造先进的晶圆级封装测试能力，致力于为客户提供从工艺开发、晶圆制造到封装测试的系统化高端制造服务，努力发展成一家国际化经营的知名半导体制造领军企业。

报告期内，公司从事的主要业务包括 MEMS 工艺开发及晶圆制造、GaN 外延材料生长及芯片设计，以及因剥离未完成而被动延续的部分原有业务；与此同时，公司围绕半导体主业开展产业投资布局，对实体企业、产业基金进行参股型投资。

报告期内，为公司贡献业绩的具体业务主要为 MEMS 芯片的工艺开发及晶圆制造。

1、MEMS 业务

公司现有 MEMS 业务包括工艺开发和晶圆制造两大类：

公司 MEMS 工艺开发业务是指根据客户提供的芯片设计方案，以满足产品性能、实现产品“可生产性”以及平衡经济效益为目标，利用工艺技术储备及项目开发经验，进行产品制造工艺流程的开发，为客户提供定制的产品制造流程。

公司 MEMS 晶圆制造业务是指在完成 MEMS 芯片的工艺开发，实现产品设计固化、生产流程固化后，为客户提供批量晶圆制造服务。

MEMS 是指利用半导体生产工艺构造的集微传感器、信号处理和电路、微执行器、通讯接口和电源等部件于一体的微米至毫米尺寸的微型器件或系统；MEMS 将电子系统与周围环境有机结合在一起，微传感器接收运动、光、热、声、磁等信号，信号再被转换成电子系统能够识别、处理的电信号，部分 MEMS 器件可通过微执行器实现对外部介质的操作功能。

2、GaN 业务

公司现有 GaN 业务包括外延材料和芯片设计两个环节：

公司 GaN 外延材料业务是指基于自主掌握的工艺诀窍，根据既定技术参数或客户指定参数，通过 MOCVD 设备生长并对外销售 6-8 英寸 GaN 外延材料。

公司 GaN 芯片设计业务是指基于技术积累设计开发 GaN 功率及微波芯片，向下游客户销售并提供相关应用方案。

GaN 是第三代半导体材料及器件的一个类别，因其禁带宽度(Eg)大于或等于 2.3 电子伏特(eV)，又被称为宽禁带半导体材料，与第一、二代半导体材料硅(Si)和砷化镓(GaAs)相比，第三代半导体材料及器件具有高热导率、高击穿场强、高饱和电子速率等优点，可以满足现代电子技术对高温、高功率、高压、高频以及抗辐射等恶劣条件的新要求。

报告期内，公司仍阶段性开展原有导航业务，包括惯性导航系统和卫星导航产品两大类。

二、集成电路及细分行业整体发展情况

2021 年是中国“十四五”开局之年，在国内宏观经济运行良好的驱动下，国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势。中国半导体行业协会统计，2021 年中国集成电路产业首次突破 1 万亿元；2022 年 1-9 月中国集成电路产业销售达 7,906.3 亿元，同比增长 15.3%。

1、MEMS 行业：

全球传感器行业市场规模达数千亿美元，而基于 MEMS 工艺批量生产的传感器件凭借其功耗低、体积小、性能出色等特点可以在各个行业和领域应用并逐步对传统传感器件进行替代。预计未来随着 MEMS 产品应用领域的不断延伸，其市场规模将迅速扩大。在移动终端上，硅麦克风、惯性传感器已被广泛采用，且耗用量仍在不断上升；另外，随着 MEMS 产品在医疗设备、工业设备、汽车电子、消费类电子等领域应用的推广和普及，市场对超声、压力、微针、芯片实验室、红外、硅光

子、射频前端、振镜、超声波换能、气体等 MEMS 器件的需求也在迅速提升；此外，物联网、可穿戴等创新设备对器件形态便捷化、微型化需求也将成为推动 MEMS 发展的新力量。

MEMS 器件目前被广泛应用于消费电子、汽车电子、工业与通讯、生物与医疗等行业。受益于 5G 通信、人工智能、移动互联网（智慧城市、智慧医疗、智慧安防）、光电通信、自动工业控制等市场的高速成长，MEMS 行业发展势头强劲。根据 Yole Development 的研究预测，全球 MEMS 行业市场规模将从 2020 年的 121 亿美元增长至 2026 年的约 182 亿美元，CAGR 达 7.2%，通讯、生物医药、工业汽车及消费电子的应用增速均非常可观，其中通讯领域的增长率最高。预计到 2026 年，10 亿美元以上的 MEMS 细分领域包括射频 MEMS（40.49 亿美元）、MEMS 惯性器件（40.02 亿美元）、压力 MEMS（23.62 亿美元）、麦克风（18.71 亿美元）以及未来应用（13.63 亿美元）。

2、GaN 行业：

近年来，随着物联网、云计算、人工智能、新能源汽车等领域的高速发展，对电能的消耗急剧增加，要求功率电子系统具有更高的能量转换效率以及更小的体积；同时，随着 5G 通信时代的来临，要求更快的数据传输速度、更低的传输延迟、更高的数据密度和增强高速应用等。而 GaN 由于具有特殊的材料压电效应，具备高频、高功率特性，在功率及微波领域均拥有巨大的需求潜力。根据 Yole Development 的研究预测，氮化镓（GaN）市场正步入高速增长，其中 GaN 功率器件的市场规模预计到 2027 年就可达 20 亿美元，2021-2027 年的复合增长率（CAGR）将高达 59%。

三、市场竞争格局

1、MEMS 业务：

MEMS 芯片制造处于产业链的中游，该行业根据设计环节的需求开发各类 MEMS 芯片的工艺制程并实现规模生产，兼具资金密集型、技术密集型和智力密集型的特征，对企业资金实力、研发投入、技术积累等均提出了极高要求。经历汽车电子、消费电子、物联网三次发展浪潮，MEMS 芯片制造行业已形成较为稳定的市场竞争格局，意法半导体（STMicroelectronics）、TELEDYNE DALSA、瑞典 Sillex、台积电（TSMC）、索尼（SONY）、X-FAB 长期保持在全球 MEMS 代工第一梯队，合计占据着超过 65% 的市场份额。截至目前，公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司在北京投资建设的规模量产线“8 英寸 MEMS 国际代工线”已投入运营，此外国内正在建设运营 MEMS 代工线的公司主要有上海先进半导体制造股份有限公司、无锡华润上华科技有限公司、中芯集成电路制造（绍兴）有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司等。

2、GaN 业务：

第三代半导体材料及器件是全球战略竞争的新领域，美国、日本、欧洲正在积极进行战略部署，我国也正在积极推进。GaN 业务是目前集成电路产业中不多的不存在显著代差的领域，且国内市场拥有巨大的需求及进口替代潜力。目前主要的 GaN 功率器件厂商有英飞凌（Infineon）、GaN systems、纳微（Navitas）、宜普（EPC）、德州仪器（TI）、Transphorm、Exagan 等；主要的 GaN 微波器件厂商有科锐（Cree）、Qorvo、Macom、NXP、住友（Sumitomo）等；主要的外延材料厂商有日本住友、日本信越、富士电机、台湾汉磊等。截至目前，国内从事 GaN 外延材料以及功率、微波器件业务的厂商主要有苏州能讯高能半导体有限公司、厦门市三安集成电路有限公司、英诺赛科（珠海）科技有限公司等。

四、公司行业地位

1、MEMS 业务

公司全资子公司瑞典 Sillex 是全球领先的纯 MEMS 代工企业，服务于全球各领域巨头厂商，且公司正在瑞典扩充产能，同时北京“8 英寸 MEMS 国际代工线”已投入运营，有望继续保持纯 MEMS 代工的全球领先地位。根据世界权威半导体市场研究机构 Yole Development 的统计数据，2012 年至今，瑞典 Sillex 在全球 MEMS 代工厂营收排名中一直位居前五，与意法半导体（STMicroelectronics）、TELEDYNE DALSA、台积电（TSMC）、索尼（SONY）等厂商持续竞争，2019-2021 年则在全球 MEMS 纯代工厂商中位居第一。随着公司境内外新增产线及产能的陆续建设及投入使用，公司将继续保持在全球 MEMS 产业竞争中的第一梯队。

2、GaN 业务

公司相关技术团队具备第三代半导体材料与器件，尤其是氮化镓（GaN）外延材料及器件的研发生产能力，在研制 8 英寸硅基氮化镓外延晶圆方面具备业界领先水平，已陆续研发、推出不同规格的产品及应用方案，同时已与境内外产业链上下游公司达成良好合作，公司属于行业的新进入者和竞争者，正在积极把握住产业发展机遇、积累业务竞争要素、奠定自身的行业地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	6,976,772,445.36	7,239,642,304.26	-3.63%	4,775,820,168.84
归属于上市公司股东的净资产	4,981,088,435.88	5,082,992,412.37	-2.00%	3,082,849,283.84
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	785,815,701.59	928,547,013.90	-15.37%	765,006,087.93
归属于上市公司股东的净利润	-73,361,142.70	205,727,463.64	-135.66%	201,096,906.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-227,909,245.60	35,856,216.12	-735.62%	5,570,164.14
经营活动产生的现金流量净额	-73,804,484.36	103,579,004.06	-171.25%	255,397,596.33
基本每股收益（元/股）	-0.10	0.31	-132.26%	0.3100
稀释每股收益（元/股）	-0.10	0.31	-132.26%	0.3100
加权平均净资产收益率	-1.46%	5.58%	-7.04%	6.83%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	173,237,171.77	204,194,655.39	177,744,064.47	230,639,809.96
归属于上市公司股东的净利润	23,605,221.18	-15,306,509.46	-6,691,869.60	-74,967,984.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,039,473.65	-19,841,057.94	-29,238,677.56	-136,790,036.45
经营活动产生的现金流量净额	36,765,242.55	-14,030,589.64	23,393,093.73	-119,932,231.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,930	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	58,122	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
杨云春	境内自然人	26.82%	196,676,719.00	152,406,414.00	质押	150,000,016.00			
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	12.05%	88,362,101.00	0.00					
中泰证券资管—证券行业支持民企发展中泰资管 2 号 FOF 集合资管计划—证券行业支持民企发展系列之中泰资管 18 号单一资产管理+	国有法人	5.00%	36,664,400.00	0.00					
中金期货有限公司—中金期货—融汇 1 号资产管理计划	境内非国有法人	1.06%	7,748,934.00	0.00					
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	5,313,305.00	0.00					
#杭州乐信投资管理有限公司—乐信长阳私募证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	4,947,153.00	0.00					
刘琼	境内自然人	0.66%	4,875,372.00	0.00					
中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	4,519,634.00	0.00					
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48%	3,533,573.00	0.00					
#夏小锋	境内自然人	0.43%	3,143,490.00	0.00					
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东杨云春、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、中泰证券资管—证券行业支持民企发展中泰资管 2 号 FOF 集合资管计划—证券行业支持民企发展系列之中泰资管 18 号单一资产管理+之间不存在关联关系，亦不存在一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系。								

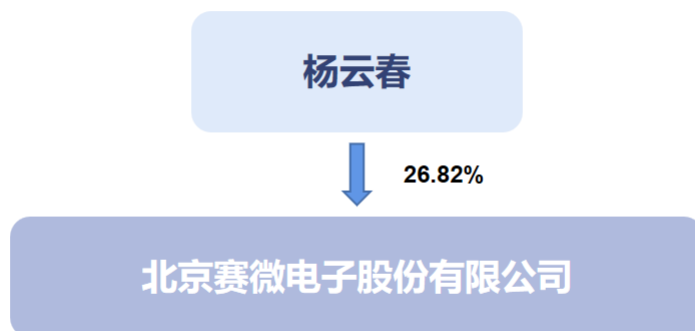
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

一、报告期内整体经营情况

2022 年，公司彻底完成重大战略转型；在复杂的国际政治经济环境下，叠加消费电子市场需求下滑等因素，公司半导体业务整体仍保持了相当的韧性并实现了较为良好的发展状态。公司主营业务 MEMS（微机电系统）工艺开发与晶圆制造具备全球竞争优势，拥有业内顶级专家与工程师团队以及持续扩张的 8 英寸成熟产能，在下游市场波动时期仍能够把握生物医疗、通讯、工业汽车、消费电子等应用领域的商业机会。

对于瑞典 MEMS 产线（瑞典 FAB1&2），在国际地缘政治冲突、通货膨胀高企、收购德国 FAB5 意外失败等的背景下，2022 年的订单、生产与销售状况仍保持良好，以瑞典克朗计价的销售收入与 2021 年保持了相同水平，但盈利水平的确因自身成本及费用、公司集团层面股权激励费用等因素而显著下降。由于瑞典克朗与人民币之间的汇率波动，导致瑞典 MEMS 产线实现的收入及利润按人民币折算后降幅进一步扩大（2022 年，瑞典克朗兑人民币的平均汇率为 0.6649，较上年水平下跌了 11.41%）。

对于北京 MEMS 产线（北京 FAB3），2022 年继续处于运营初期、产能爬坡阶段，代工晶圆中已实现量产的消费电子产品市场需求下滑、客户的订单和回款情况不及预期，而通信、工业汽车、生物医疗领域附加值较高的代工晶圆仍处于工艺开发、产品验证或风险试产阶段，尚未进入量产阶段。因此，北京 MEMS 产线实现的收入虽然较上期增幅显著，但与此前设定的股权激励目标（3.50 亿元）差距较大；与此同时，产线的产能建设和人员团队扩充工作持续进行，折旧摊销压力巨大，工厂运转及人员费用也进一步增长，同时继续保持了极高的研发强度，叠加公司集团层面股权激励费用等因素，北京 MEMS 产线在 2022 年的亏损规模进一步扩大。

公司为把握市场机遇、构建长期竞争力，继续增加半导体业务的资本投入和人员招聘，保障核心业务 MEMS 和潜力业务 GaN（氮化镓）的持续投入，叠加公司 2021 年限制性股票激励计划的实施，本报告期内相关管理费用大幅增长，研发费用继续处于较高投入水平。另外，公司在报告期出售了部分参股子公司的股权，投资参与的半导体产业基金等继续处于回报期，虽然同时长期股权投资整体出现亏损，但公司整体上仍实现了较大的投资收益。

二、报告期内重要事项

（一）投融资事项

报告期内，为更好地服务于主业发展，公司根据长期发展战略继续积极开展投融资活动，一方面根据发展需要投资新设业务子公司、继续实施针对企业与基金的相关产业投资；另一方面积极推动公司层面的股权激励的实施，并支持旗下参控股子公司融资；与此同时，公司完成剥离原有航空电子、导航等非半导体业务，资源持续导向聚焦于战略性 MEMS 与 GaN 业务。MEMS 方面，公司继续支持瑞典 FAB1&FAB2、北京 FAB3 扩充产能，推进建设 MEMS 先进封装测试产线。

其他产业投资方面，公司参与投资 2 家境内企业及 1 家产业投资基金，包括展诚科技、依迈微、北京传感基金。存量投资动态方面，公司继续从半导体产业基金、中科昊芯部分股权退出取得投资收益；出售全资子公司耐威时代及中测耐威 100%股权。

融资方面，公司 2022 年新增银行授信 4.5 亿元。

（二）重大业务事项

1、与合肥高新区签署《合作框架协议》

2022 年 1 月 1 日，公司与合肥高新技术产业开发区管理委员会签署了《合作框架协议》，拟在合肥高新区投资建设 12 吋 MEMS 制造线项目，旨在充分利用当地优势资源要素，尤其是集成电路产业链及下游应用产业优势，积极把握半导体产业发展机遇，促进公司特色工艺晶圆代工业务的进一步发展。截至目前，该产线的推进工作暂处于搁置状态。

2、与北京怀柔经信局签署《合作协议》

2022 年 1 月 29 日，公司控股子公司海创微芯与北京市怀柔区经济和信息化局签署了《合作协议》，拟在怀柔区投资建设并运营 6/8 英寸 MEMS 晶圆中试生产线和研发平台、先进 MEMS 工艺设计与服务北京市工程研究中心、8 英寸晶圆级封装测试规模量产线。截至目前，该产线的相关准备工作仍在进行中。

3、北京 FAB3 与某国际知名激光雷达厂商及其子公司签署《战略合作框架协议》

2022 年 4 月 1 日，公司控股子公司赛莱克斯北京与某国际知名激光雷达厂商及其子公司签署了《战略合作框架协议》，有利于公司积极把握全球半导体特色工艺制造产业，尤其是全球汽车芯片、MEMS 芯片制造需求快速增长的发展机遇，从而促进公司业务的进一步发展。

4、北京 FAB3BAW 滤波器通过验证并启动试产

2022 年 6 月 12 日，公司控股子公司北京 FAB3 代工制造的某款 BAW (Bulk Acoustic Wave, 带谐振腔体声波滤波器，包括 BAWSMR-固体安装谐振器和 FBAR-薄膜体声波谐振器) 通过了客户验证，经过对该批次 BAW 滤波器进行频段抑制、带内插损、电压驻波比等性能测试及高加速温湿度应力、高低温贮存寿命、机械及跌落冲击等可靠性验证，性能、良率均达到或优于设计指标要求，与国际射频巨头厂商的同类别产品指标相当。该客户已同步签署试产订单，北京 FAB3 启动首批 BAW 滤波器 8 英寸晶圆的小批量试生产。

5、北京 FAB3 某款 MEMS 气体传感芯片通过验证并启动试产

2022 年 11 月，赛莱克斯北京代工制造的某款 MEMS 气体传感芯片通过了客户验证，该客户已同步签署试产订单，赛莱克斯北京启动首批 MEMS 气体传感芯片 8 英寸晶圆的小批量试生产。

6、瑞典子公司收购德国汽车芯片制造产线被德国联邦经济事务与气候行动部禁止

2022 年 11 月 9 日晚间（北京时间），公司及境内外相关子公司收到德国联邦经济事务与气候行动部的正式决定文件，禁止瑞典 Sillex 收购德国汽车芯片制造产线。

7、北京 FAB3 与武汉敏声 BAW 滤波器联合产线实现通线

2022 年 12 月，赛莱克斯北京与武汉敏声合作共建的 8 英寸 BAW 滤波器联合产线达到各项要求和标准，实现通线，具备进行下一步产能爬坡、良率提升及大规模量产的基础。

（三）子公司其他事项

1、中科昊芯股权退出

2022 年 1 月，微芯科技将其持有的中科昊芯全部 22.6597% 股权以 6,190.09 万元的价格转让给顶芯未来（海南）科技中心（有限合伙）。2022 年 2 月，本次转让已完成工商变更登记，中科昊芯不再是公司参股子公司。

2、光谷信息 IPO 终止

2022 年 3 月 25 日，光谷信息收到北京证券交易所出具的《关于终止对武汉光谷信息技术股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市审核的决定》（北证发[2022]13 号）。根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）》第五十三条有关规定，北京证券交易所决定终止光谷信息公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核。

3、出售耐威时代 100% 股权

2021 年 3 月 16 日公司召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，以及 2021 年 4 月 6 日召开的 2020 年年度股东大会分别审议通过了《关于全资子公司股权转让暨募投项目转让的议案》，同意公司将其持有的全资子公司耐威时代 100% 股权以 37,350.00 万元的价格转予青州市宏源国有资产经营有限公司。

2021 年 5 月 12 日，耐威时代收到北京市国防科学技术工业办公室下发的《关于北京耐威时代科技有限公司重组涉及军工事项审查的批复》（京军工[2021]66 号），经报国防科工局批准，同意耐威时代本次重组，即同意公司将所持有的耐威时代 100% 股权转让给青州市宏源国有资产经营有限公司。

2021 年 6 月 30 日公司召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，以及 2021 年 8 月 25 日召开的 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于全资子公司股权转让交易调整的议案》，同意公司签署《股权转让协议补充协议》。因交易情况发生变化，各方基于实际情况，经友好协商，变更原协议项下的股权转让标的范围、交易对价、价款支付等交易内容，调整后的交易对价为 18,121.71 万元。

本次股权转让已于 2022 年 3 月完成工商变更登记。

4、控股子公司赛积国际增资

2022 年 4 月，公司使用 1 亿元募集资金向全资子公司赛积国际进行货币出资，用于 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目“MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目”的建设，同时公司以位于北京经济技术开发区路东区 F2 街区 F2M3 地块的房屋建筑物和土地使用权向赛积国际进行增资，增资涉及的房屋建筑物和土地使用权于 2022 年 3 月完成相应变更程序，因此公司最终以该等增资资产截至 2022 年 3 月的账面价值 17,194.052966 万元对赛积国际进行增资。本次增资完成后，赛积国际注册资本由 10,000 万元人民币增加至 27,194.052966 万元人民币。

5、调整控股子公司中科赛微股权结构

2022 年 5 月，公司控股子公司中科赛微股东北京中科微投资管理有限责任公司、极芯传感分别转让各自持有的中科赛微 30% 股权。其中中科微投资将其持有中科赛微的未实缴 17.14% 的认缴出资权以 0 元对价转让给微芯科技，将其持有中科赛微的未实缴 12.86% 的认缴出资权以 0 元对价转让给北京迈领科技合伙企业（有限合伙）；极芯传感将其持有中科赛微的未实缴 30% 的认缴出资权以 0 元对价转让给迈领科技。本次交易完成后，微芯科技持有中科赛微 57.14% 股权，迈领科技持有中科赛微 42.86% 股权，中科赛微仍为公司控股子公司。

6、受让极芯传感合伙份额

2022 年 7 月，公司全资子公司微芯科技担任执行事务合伙人的有限合伙企业极芯传感合伙人微芯科技、北京迈领科技合伙企业（有限合伙）分别转让各自持有的极芯传感合伙份额。其中微芯科技将其持有的极芯传感未实缴 39% 合伙份额以 0 元对价转让给公司，迈领科技将其持有的极芯传感未实缴 60% 合伙份额以 0 元对价转让给公司。本次交易完成后，公司持有极芯传感 99% 合伙份额，公司全资子公司微芯科技持有极芯传感 1% 合伙份额，微芯科技仍为极芯传感执行事务合伙人。

7、控股子公司赛莱克斯北京增资

2022 年 8 月，根据公司业务发展的实际情况、所处阶段以及北京 FAB3 在集团 MEMS 业务体系中的重要地位，出于为北京 FAB3 搭建员工长期激励平台的考虑，公司现拟由极芯传感出资 10,759.45 万元对赛莱克斯北京进行增资，其中

10,526.32 万元计入注册资本，233.13 万元计入资本公积。本次增资完成后，赛莱克斯北京的注册资本将由 200,000.00 万元增加至 210,526.32 万元。

8、出售中测耐威 100%股权

2022 年 8 月，公司与北京金鹰旭谱信息技术有限公司签署《股权转让协议》，将公司持有的全资子公司中测耐威 100% 股权以 2,059,177.70 元的价格转让给金鹰旭谱。本次交易完成后，公司不再持有中测耐威股权，中测耐威不再纳入公司合并报表范围。2022 年 10 月，本次转让已完成工商变更登记。

9、投资智能传感基金

2022 年 11 月，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 2.50 亿元，占合伙企业总认缴出资额的 25.00%；公司参股子公司赛微私募作为普通合伙人以自有资金认缴出资人民币 400.00 万元，占合伙企业总认缴出资额的 0.40%。

二、报告期后事项

1、北京 FAB3 某款 MEMS 生物芯片通过验证并启动试产

2023 年 1 月，北京 FAB3 代工制造的某款 MEMS 生物芯片通过了客户验证，该客户已同步签署试产订单，启动首批 MEMS 生物芯片 8 英寸晶圆的小批量试生产。

2、2021 年限制性股票首次授予部分第一个归属期归属限制性股票上市

2023 年 3 月，公司 2021 年限制性股票首次授予部分第一个归属期归属登记完成，该部分限制性股票于 2023 年 3 月 17 日上市流通。

3、瑞典 Sillex 收购 Corem Science Fastighets AB 100%股权

2023 年 3 月 16 日，公司召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于瑞典子公司收购 Corem Science Fastighets AB 100%股权的议案》，瑞典 Sillex 以 2.94 亿瑞典克朗收购 Corem Stockholm Holding AB 持有的 Corem Science Fastighets AB 100%股权。本次交易完成后，公司将通过瑞典 Sillex、Sillex Securities AB 间接持有 Corem Science Fastighets AB 100%股权及其现有土地和地上建筑物等资产。

4、聚能国际股权调整

因 GaN（氮化镓）制造业务发展需要，公司参股子公司聚能国际的股权结构进行了调整，股东山东嘉俊投资管理有限公司将其持有的聚能国际未实缴的 65%认缴出资权以零对价转让给公司参股子公司北京赛微私募基金管理有限公司，公司控股子公司青岛聚能创芯微电子有限公司暂未参与本次认缴出资权的受让。2023 年 3 月 22 日，公司收到聚能国际通知，其已在青州市行政审批局完成与本次股权变动相关的工商变更登记手续。